

## Unsere Technologien in der SMT-Fertigung

### **Lasermarkiersystem Mühlbauer**

- Beschriftungsfläche 360mm x 360mm
- Integrierte Wendeeinheit

### **Reinigungsstation ASYS**

- Berührungslose, antistatische Reinigung von unbestückten Leiterplatten
- Oberseitenreinigung



### **Lotpastendrucker DEK**

- Simultanes Ein- und Ausfahren der Leiterplatten für verkürzte Kernzykluszeiten
- Unterseitenreinigung

### **Lotpasteninspektionssystem ASMPT**

- Kombiniert optische 2D- und 3D- Messverfahren
- 3D-on-the-fly-Kompensierung der Leiterplattenverwölbung für hohe Messgenauigkeit

### **SMD-Bestückungssystem Fuji**

- Von der Prototypen- bis zur Serienfertigung - Bestückungsgenauigkeit  $\pm 0.050\text{mm}$   $\text{cpk} \geq 1.00$
- Bestückungsleistung von 120000BE/h

### **Reflow-Konvektionslötssystem REHM**

- Hocheffizientes Reflow-Konvektions-Lötssystem
- Flexibles Transportsystem mit Mittenunterstützung

### **Inline 3D-AOI-System Omron**

- Vollautomatisiert mit einer Auflösung bis zu  $15\mu\text{m}$
- 3D-Rekonstruktion durch Farbhight- und Phasenverschiebungstechnologie

## Unsere Technologien in der THT-Fertigung

### **Konventionelle Handbestückung**

- Bestückung mittels elektronischer Visualisierung
- Komplette Bestückung von Prototypen möglich

### **Volltunnel-Wellenlötssystem SEHO**

- Effektive Konvektionsvorheizung für homogene & bauteilschonende Erwärmung von Baugruppen
- Frei konfigurierbarer Vorheizbereich von 1800 mm bis 3300 mm Länge



### **Selektivlötanlage SEHO**

- Patentiertes SYNCHRO-Konzept ermöglicht sequenzielle, parallele oder synchrone Baugruppenbearbeitung
- Elektromagnetische Lötseinheiten mit innovativen Lötdüsen für Miniwellen- und Multiwellen-Prozesse

### **Manueller Lötprozess**

- Handlöten nach IPC-A-610 Klasse 2, auf Kundenwunsch IPC-A-610 Klasse 3
- Handlöten nach WHMA-A-620

### **Stand-Alone-Nutzentrenner Schunk**

- Flexible Erstellung von Werkstückträgern mittels Magnet-Stiften
- Kürzeste Taktzeiten in einem Fräsbereich von 500x600mm

## Unsere Technologien im Bereich Montage

### Gruppenfertigung

- Linienfertigung
- Inselfertigung

### Montageprozesse

- Montagearbeiten elektronischer Komponenten
- Vor- und Endmontage komplexer Baugruppen

### Verschiedene Montagetechnologien

- Press-Fit Technologie & Ultraschallschweißen
- (Teil-) automatisierte Montage & Schraubtechnologien
- Robotertechnologie & Verguss- und Klebeverfahren



## Unsere Technologien im Bereich Test & Prüfung

### Lotpasteninspektionssystem

- Kombiniert optische 2D- und 3D- Messverfahren
- 3D-on-the-fly-Kompensierung der Leiterplattenverwölbung für hohe kontinuierliche Messgenauigkeit

### Inline 3D-AOI-Systems

- Vollautomatisiert mit einer Auflösung bis zu 15µm
- 3D-Rekonstruktion durch Farbhightlight- und Phasenverschiebungstechnologie

### Elektrische Tests

- Boundary Scan
- In-Circuit-Test (z.B. mittels Nadelbettadapter)

### Funktionstests

- Konzeption und Durchführung von kundenspezifischen und komplexen Funktionstests
- Besondere Spezialisierung im Bereich Hochfrequenz mittels Netzwerk- und Spektrumanalysatoren



### Prüfsoftware

- Erstellung der Prüfsoftware durch eigene Software-Ingenieure
- Persönliche Unterstützung unserer Kunden für die Umsetzung projektspezifischer Prüfanforderungen

## Unsere Zertifizierungen

- DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, DIN ISO 50001
- RoHS- und REACH-konforme Fertigung
- Fertigung der Leiterplatte gem. IPC-A-610 Klasse 2, auf Kundenwunsch IPC-A-610 Klasse 3

## Unser Kontakt

### KATHREIN Sachsen GmbH

Lindenstraße 3  
09241 Mühlau  
Deutschland  
Tel.: +49 3722 6073-10  
Mail: sales@kathrein-sachsen.de  
www.kathrein-sachsen.de